# 電解めっき法における機能性微粒子を用いた

# 複合めっき膜の作製と性能評価

# 宗本隆志\* 上村彰宏\* 嶋田一裕\*

本研究では、各種機能性微粒子を用いた複合めっき膜を電解めっき法で作製し、その硬さと耐食性について評価した。 機能性微粒子として高耐食の機能を有するチタン合金粒子およびステンレス鋼(SUS)粒子、高硬度の機能を有する酸化 アルミニウム(Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)ナノ粒子を用いた。ニッケルめっき浴中に各種機能性微粒子を添加しながら電気めっきを行うこと で、ニッケルめっき膜中に各種機能性微粒子が含有した複合めっき膜を作製した。蛍光X線分析より、複合化されたチ タン合金およびSUS粒子の濃度はそれぞれ6%および10%程度と算出された。チタン合金粒子およびSUS粒子はめっき膜 内部に複合化しており、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>ナノ粒子はめっき膜表面に濃集していた。硬さは、それぞれの複合めっき膜において研 磨の有無にかかわらず約200-250 HVであり、複合化されていないニッケルめっき膜と同程度であり有効性を示さなかっ た。腐食電位試験による耐食性では、研磨前の各種複合めっき膜と研磨後のAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>ナノ粒子複合めっき膜は複合化され ていないニッケルめっき膜と同程度であったが、研磨後のチタン合金粒子およびSUS粒子複合めっき膜では複合化され

キーワード: 電解めっき, 複合めっき, 機能性微粒子

### Fabrication and Characterization of Functional Fine Particle Composite Electroplating

#### Takashi Munemoto, Akihiro Uemura and Kazuhiro Shimada

We conducted composite electroplating using various functional fine particles and estimated the hardness and corrosion potential of the composite electroplating. We used titanium alloy and stainless steel (SUS) particles with corrosion resistance and aluminum oxide (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) nanoparticles with high hardness. The composite electroplating was conducted in a nickel (Ni)-plating bath while adding various functional fine particles. X-ray fluorescence analysis showed that the concentrations of the composite titanium alloy and SUS particles were calculated to be about 6% and 10%, respectively. Titanium alloy particles and SUS particles were co-deposited on the inside of the Ni-plating, while Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> nanoparticles were concentrated on the surface of the plating. The hardnesses of the composite plating were approximately 200-250 HV irrespective of polishing, almost the same as that of the Ni-plating. Unfortunately, our results did not show any improvement in hardness. Corrosion resistance was estimated by a corrosion potential test. The corrosion resistance of each composite plating before polishing and Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> nanoparticle composite plating after polishing were almost the same as that of Ni plating. Our results suggested that the titanium alloy particle and SUS particle composite plating after polishing was better than that of Ni plating. Our results suggested that the titanium alloy particle and SUS particle composite plating could improve corrosion resistance.

Keywords: electroplating, composite plating, functional fine particle

#### 1.緒 言

金属材料の表面処理は,スパッタ法や蒸着法といっ た乾式の成膜方法とめっき法に代表される水溶液中で 成膜する湿式の成膜方法が知られている。めっき法は 真空や高電圧を必要とせず単純な装置で成膜でき,高 い生産性を有するメリットがある。

めっき法は,主に電気のエネルギーを使って金属膜 を析出させる電解めっき法と化学反応のエネルギーを 使った無電解めっき法に分類される。無電解めっき法 は均一なめっき処理が可能で複雑な形状でもめっきが 可能であるが,コストが高く処理時間が長くなってし まう<sup>1)</sup>。一方,電解めっき法は成膜速度が速く,低コ

\*化学食品部

ストで様々な金属材料に処理が可能である。

めっき浴中に微粒子を懸濁させながら成膜を行い, 金属膜中に微粒子を複合化させることで、金属と微粒 子の複合皮膜を作製する複合めっきが知られている<sup>2)</sup>。 複合めっきは, 耐摩耗性や耐食性などを改良させる目 的で,様々な機能性を有する微粒子を対象に研究が行 われてきた3)。複合めっきでは、均一かつ複雑な形状 に処理が可能な特徴を活かして、主に無電解めっき法 を対象に研究開発が行われている。例えば、無電解ニ ッケルめっき皮膜中に撥水機能を有する微粒子を複合 化させた, 高撥水めっき皮膜が実用化されている4)。 しかしながら、電解めっき法による複合めっきに関し て作製例は少なく、その有効性については検討されて きていない。電解めっき法での機能性微粒子と金属め っきを複合化させた複合めっきが高機能を発現できれ ば, 電解めっき法のメリットである速い成膜速度や低 コストで様々な金属材料に処理可能となり新たな機能 性めっきを創出できる可能性がある。

そこで本研究では、各種機能性微粒子を用いた複合 めっき膜を電解めっき法で作製し、その性能を評価し 有効性について検討した。なお、本研究では、硬度と 耐食について着眼したため、高耐食の機能を有するチ タン合金粒子及びステンレス鋼(SUS)粒子、高硬度の 機能を有する酸化アルミニウム(Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)ナノ粒子を 選定した。

# 2. 実験方法

# 2. 1 複合めっき膜の成膜

本研究では、冷間圧延鋼板(SPCC)を母材として各種 複合めっき膜を成膜した。複合めっきの金属膜として、 ワット浴から析出させるニッケルめっき金属膜を用い、 複合化させる微粒子として、チタン合金粒子(ランド トレーディングLCC、粒径:約50-100 µm)、SUS粒子 (㈱ソディック、粒径:10-50 µm) Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>ナノ粒子 (TECNAN、粒径:約10-20 nm)を用いた。複合めっ き条件および浴組成は表1に示す。複合めっきにおい て、複合化させる粒子は凝集して沈降するため、めっ き槽はガラス管とPTFE基板をOリングシールで締め固 定するセルを用い、母材はガラス管と基板の間に挟み 込みながら成膜を行った(図1)。

#### 2.2 複合めっき膜の評価

第2.1節の方法で成膜した複合めっき膜を対象に,

〒1	
NiSO4·6H2O	1.3 mol/L
NiCl2·6H2O	0.2 mol/L
H <sub>2</sub> BO <sub>3</sub>	0.6 mol/L
pН	4
浴温度	25 °C
電流密度	$10 \text{ A/dm}^2$
粒子の濃度	2 g/L



図1 複合めっき槽の模式図

蛍光X線微小部膜厚計(㈱日立ハイテクサイエンス, EA6000VX)を用いためっき膜中に複合化した粒子の定 性分析,元素分析機能付き走査型電子顕微鏡(日本電子 ㈱, JSM-6510LA)を用いた断面観察を行った。性能 評価として,ビッカース硬さ試験機(㈱アカシ, MVK-H2)を用いた硬さ測定,電気化学測定システム (HZ-5000, 北斗電工㈱)を用いた腐食電位の測定を行 った。複合めっき膜の成膜後の微粒子は,ニッケルめ っき膜の内部に複合化していることが予備実験の結果 から分かっている。そのため,硬さ測定および腐食電 位の測定は,複合めっき膜表面を研磨した試料および 未研磨試料に対して行った。

#### 3. 結果および考察

#### 3.1 複合めっき膜の観察

図2に、チタン合金粒子およびSUS粒子複合めっき膜 の蛍光X線分析結果を示す。チタン合金粒子複合めっ きの蛍光X線のスペクトルから、NiおよびTiのピーク、 SUS粒子複合めっきの蛍光X線のスペクトルから、Ni, CrおよびFeのピークが確認された。Al2O3ナノ粒子複 合めっき膜については、蛍光X線による定性分析では 感度不足によりAlのピークを検出することができなか った。Niのピークは金属膜由来、TiおよびCrは複合化 させた粒子由来のピークを示す。スペクトルの強度か ら理論的に算出される複合化されたチタン合金粒子お よびSUS粒子の濃度ははそれぞれ6%および10%であっ た。



図2 チタン合金粒子複合めっき膜(a)およびSUS粒子複合 めっき膜(b)の蛍光X線分析結果

図3に、電子顕微鏡による複合めっき膜の表面およ び断面観察結果を示す。本研究で成膜した複合めっき 膜の表面は数10-100 µm程度の突起を有していた(図3a, 図3cおよび3e)。めっき膜断面の元素分析結果から、チ タン合金およびSUS粒子はニッケルめっきの内部に複 合化していることが分かった(図3b, 図3d)。一方、 Al2O3ナノ粒子はめっき膜の表面に濃集していること が分かった(図3f)。複合した粒子の複合化状態の違い については、チタン合金粒子およびSUS粒子は電気を 通しやすいため、母材におけるめっき膜の成長にとも なって、粒子表面においてもめっき膜の成長にとも なって、和2-203ナノ粒子は電気を通しにくいため、めっ き膜の成長にともなう膜内部に複合化できなかったも のと考えられる。



図3 複合めっき膜の電子顕微鏡観察・元素分析結果結果 (a), (b) チタン合金粒子複合めっき膜の表面観察およびTi 分析結果, (c), (d) SUS粒子複合めっき膜の表面観察およ びCr分析結果, (e), (f) Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>ナノ粒子複合めっき膜の表 面観察結果およびAl分析結果

#### 3. 2 複合めっき膜の硬さ

複合めっき膜の断面観察結果から,複合させた粒子 はめっき膜内部に複合化していたため,硬さ測定は成 膜後に表面を研磨した試料および未研磨試料を対象に 測定した。図4に、それぞれの粒子を用いた複合めっ き膜のビッカース硬さ試験結果を示す。すべての複合 めっき膜の硬さは約200-250 HVであり、めっき表面の 研磨の有無による硬さの変化は認められなかった。複 合化されていない一般的なニッケルめっき膜のビッカ ース硬度は、約200 HVと報告されている<sup>5</sup>。本研究で 成膜した複合めっき膜の硬さは複合化されていないニ ッケルめっき膜と同程度であった。

# 3.3 複合めっき膜の耐食性

複合めっき膜の耐食性について、1M, NaCl水溶液 中における腐食電位測定結果を図5に示す。腐食電位 は、値が高いほど良好な耐食性を示す。本研究で母材



図4 複合めっき膜の硬さ測定結果 3回測定の平均値、エラーバーは標準偏差を示す

として用いたSPCC鋼板およびニッケルめっき膜の腐 食電位は、それぞれ約-500 mVおよび-350 mVであっ た。研磨前の複合めっき膜の腐食電位は、複合させた 粒子の種類にかかわらず、ニッケルめっき膜と同等の 約-350 mV程度であった。研磨後のAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>ナノ粒子複合 めっき膜の腐食電位は未研磨試料と同等で、約-350 mVであった。チタン合金およびSUS粒子複合めっき膜 の研磨後の腐食電位は約-200 mVであり、研磨前と比 べて約150 mVの腐食電位(耐食性)を向上させることが できた。



図5 複合めっき膜の腐食電位測定結果 3回測定の平均値,エラーバーは標準偏差を示す

複合めっきに対する腐食電位は, 複合化された粒子 が脱落することによって複合化の効果が喪失される<sup>6</sup>。 本研究で成膜したAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>ナノ粒子複合めっき膜の電子 顕微鏡観察結果から、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>ナノ粒子は複合めっき膜 の表層部に濃集していることが確認されている(図3f)。 そのため、表層に形成されたAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>ナノ粒子の脱落に よって腐食電位が向上しなかったと考えられる。

チタン合金粒子およびSUS粒子複合めっきにおける めっき研磨後の腐食電位の向上は、研磨によって複合 化粒子を表面に露出させたことで腐食反応を抑制し、 耐食性が向上したものと考えられる。以上のことより、 チタン合金粒子およびSUS粒子を複合化することで耐 食性については有効であることが示唆された。

### 4.結 言

チタン合金粒子,SUS粒子,Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>ナノ粒子を用いて 複合めっき膜を電解めっきで作製し、測定したところ 以下のことが分かった。

- (1) 複合めっき膜の蛍光X線分析結果から,複合化さ れたチタン合金粒子およびSUS粒子の濃度はそれぞ れ6%および10%程度と算出された。
- (2) チタン合金およびSUS粒子ではめっき膜内部に複合化していたが、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>ナノ粒子はめっき表面に濃 集していることが明らかとなった。
- (3) 複合めっき膜の硬さは粒子の種類および研磨の有 無にかかわらず、約200-250 HVであり、複合化さ れていないニッケルめっき膜と同程度であり有効 性を示さなかった。
- (4) 研磨前の複合めっき膜の腐食電位および研磨後の Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>ナノ粒子複合めっき膜の腐食電位は複合化されていないニッケルめっき膜と同程度であったが、 研磨後のチタン合金粒子およびSUS粒子複合めっき 膜は耐食性が向上しており有効性を示した。

#### 参考文献

- 1) 田代雄彦. 無電解ニッケルめっき. 表面技術. 1999, 50巻, 2, p. 140-145.
- 古川直治. 複合めっきの現状と将来. 表面技術. 2000, 51巻, 11号, p. 1056–1061.
- 3) 松原浩. ナノ粒子の複合めっき. 表面技術. 2011, 62巻, 12 号, p. 594-601.
- 4) 西川賢一. 無電解Ni-P/PTFE複合めっき. 表面技術. 2015, 66巻, 11号, p. 499–502.
- Fengyan Hou, Wei Wang, Hetong Guo. Effect of the dispersibility of ZrO<sub>2</sub> nanoparticles in Ni–ZrO<sub>2</sub> electroplated nanocomposite

coatings on the mechanical properties of nanocomposite coatings. Applied Surface Science. 2006, vol. 252, p. 3812–3817.

6) 土居悠帆, 日野実, 村上浩二, 村岡 賢, 平松実. 硫酸塩浴

からのZn-Ni-SiO<sub>2</sub>複合めっきの析出挙動および耐食性に及 ぼす不溶性アノードの影響.表面技術. 2018. 69巻, 3号, p. 118–122.